

证券代码：301338 证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☐特定对象调研☐分析师会议 ☐媒体采访☐业绩说明会 ☐新闻发布会☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、招商证券、中国银河证券、国信证券、长城证券、华源证券、东莞证券等 21 名投资者
时间	2025 年 05 月 21 日（周三）下午 15:30-17:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事长邱国良 2、总经理刘小宁 3、董事会秘书邱靖琳 4、投关经理江正才
投资者关系活动主要内容介绍	公司基本情况介绍： 投关经理江正才先生详细介绍了公司发展的主营业务、技术优势和研发创新情况。 公司与参会人员就以下问题进行了探讨： 1、AI 终端（手机、眼镜、耳机等）对行业的影响，对 2025 年景气度的展望 答：随着人工智能的广泛应用，带动算力相关硬件设施的扩容；数据流量增长，带动网络设备的需求；AI 大模型与终端产品的结合，推动消费电子产品需求的回暖，从而带来设备

的需求上升。同时，AI 产品对印刷的精度、良率要求更高，促使客户购买高端产品。根据 IDC 预估，2024 年全球 AI 手机销量有望增长至 1.70 亿台，约占智能手机整体出货量的 15%，同比增速达到 233%。根据 Canalys research 预估，2024 年全球 AI PC 出货量将占 PC 出货总量的 18%，达到 4800 万台；到 2028 年，全球 AI PC 出货量将达到 2.05 亿台。2024 年至 2028 年期间的复合年增长率将达到 44%。

2、LED 行业的情况，公司业务进展情况和展望

答：LED 下游应用汉族要分为 LED 照明和 LED 显示，目前应用主要集中在照明领域。随着新兴产品渗透率越来越高，LED 应用市场规模将逐步扩张。根据 TrendForce,2024 年全球 LED 照明市场产值 560.58 亿美元，但存在智能照明、植物照明市场增长的结构性机遇。新型显示如小间距、Mini LED 的需求保持较快速的发展，根据 Omdia，2024 年 mini LED 背光电视出货量翻倍增长，预计 2025 年出货量将达到 930 万台。根据洛图科技预计，mini LED 直显全球市场规模 2024-2028 年复合增长率约 40%。

市场容量增长的同时，LED 封装设备的需求也将随之增长，TrendForce 集邦咨询数据显示，2024 年全球 LED 封装市场规模达 127 亿美金。

公司 LED 固晶机在取得大客户突破之后，提高了行业的品牌知名度和市场占有率，之前小批量采购的客户加大了采购的力度，大客户新突破较多，同时 Mini 固晶机出货量取得较快增长。

公司将持续投入研发，升级产品，提高产品竞争力。近期，公司推出全新一代 MLED 专用超高速固晶机 S20，UPH 最高可达 270K/H，固晶精度±15um，晶片修正角度精度±1.5°，在精度、速度、节能、稳定性方面更有优势，助力客

户节约成本。

3、半导体业务的布局，当前进展，未来展望

答：尽管当今的市场环境及国际地缘政治复杂，公司计划面向半导体制程成立 SIP 封装事业部，推出 SIP 相关系列新产品，赢得新市场，收获新成长。公司为 SIP 先进封装领域提供的产品有印刷设备、点胶设备、贴片设备、植球设备。

另外公司储备了面向第三代半导体领域的 SIC 晶圆老化测试设备及 SIC KGD 芯片分选设备，主要应用于新能源汽车、新能源发电、工业与航空航天等领域。

4、公司未来的增长点在哪里？

答：公司深耕自动化精密装备主业的同时，将结合市场发展，通过七大共性技术模块的研发中心及高效的产品孵化体系，持续加大新领域的研发，主要工艺方向有半导体、汽车电子、MiniLED 等领域。

锡膏印刷设备，受高端应用领域需求增长带来的机会，毛利率提升显著，同时公司在汽车电子、半导体等应用领域市场占有率持续提升。点胶设备市场空间相对较大，近年来公司扩大资源投入，核心零部件实现自足自给，产品不断升级迭代，逐步获得电子装联行业客户的认可，老客户新产品策略效果良好，市场占有率持续提升。LED 封装设备阶段性整体收入变化不大，更多的是毛利率的提升和 mini 固晶机市占率的提升。柔性自动化产品被全球多家知名客户认可，成功开拓光通讯行业应用场景，推出 800G 光模块自动化线体，整体盈利能力显著提升。

公司战略布局 SIP 事业部，目前应用于 SIP 领域主要有印刷设备、植球设备、点胶设备、固晶设备等。未来围绕 SIP 先进封装，公司战略发展方向，将投入更多资源，重点发展。

	5、锡膏印刷设备的市场占有率还有提升空间吗？ 答：锡膏印刷设备属于 SMT 及 COB 产线的关键核心设备，一般用到 PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及，对产品的良率有重大影响。PCB 的应用领域伴随着工业领域自动化、智能化需求的不断提升，公司的锡膏印刷设备下游扩展至 AI 终端、汽车电子、AR/VR、智能穿戴、智能家居、安防等新兴行业，需求总量增加。 近年来我国电子装联设备国产替代进口的进程不断加速，公司在锡膏印刷设备高端市场的占有率有望持续提升。 依托新加坡子公司 GKG ASIA 覆盖并由其为海外客户提供技术支持与服务，子公司在马来西亚、越南、印度、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服务网点，为海外客户提供优质服务。2024 年度公司产品公司海外收入占公司营业收入比为 14.58%，海外市场占有率还有进一步提升的空间。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 5 月 21 日